

2023 年 4 月 21 日

各 位

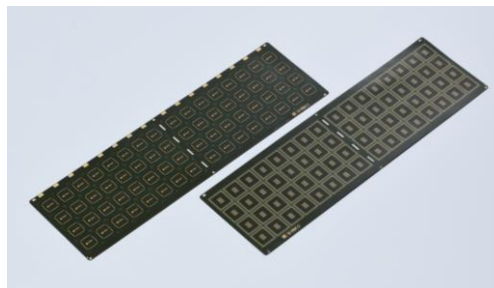
長野県長野市小島田町 80 番地
新 光 電 気 工 業 株 式 会 社
(証券コード 6967)

プラスチック BGA 基板の「IATF 16949」の認証取得について

当社は、「半導体メモリー向けプラスチック BGA 基板の設計・製造」について、自動車産業の国際的な品質マネジメントシステム規格である「IATF 16949」の認証を取得いたしましたので、お知らせいたします。

自動車用半導体は、カーエレクトロニクスの主要部品として需要が拡大しており、当社のプラスチック BGA 基板は、高い信頼性が求められる自動車用半導体のパッケージ基板として使用されています。今後、自動車向けに半導体メモリーの高速・大容量化がさらに進むことから、信頼性の高い製品の提供とさらなる品質向上が求められています。当社は、お客様からのご要望に沿った品質に対応するため、「IATF 16949」に基づく品質マネジメントシステムの導入を推進し、規格取得に向けて取り組んだ結果、このたびの認証取得となりました。

「IATF 16949」は、ISO 9001 をベースとして、自動車産業固有の厳しい要求事項が追加された自動車産業向け品質マネジメントシステムの国際標準規格です。世界の多くの自動車メーカーや自動車産業に関わるサプライヤーにおいて、自動車部品のグローバルな調達基準として採用されています。当社は、今回の認証取得を通じ、継続的な品質改善に取り組み、より高品質な自動車向け製品の安定供給に努めてまいります。



プラスチック BGA 基板

【認証取得の内容】

- | | |
|---------------|---|
| (1) 対象規格 | : IATF16949 (第一版) |
| (2) 認証機関 | : Bureau Veritas Certification Holding |
| (3) IATF 認証番号 | : 0466474 |
| (4) 認証機関認証番号 | : JP023232-IATF |
| (5) 認証日 | : 2023 年 1 月 13 日 |
| (6) 認証組織名 | : 新光電気工業株式会社第二 PLP 事業部新井工場 |
| (7) 認証範囲 | : Design and manufacturing of Substrate for semiconductor memory device.
(半導体メモリーデバイス向け基板の設計・製造) |

以 上

●お問い合わせ先

新光電気工業株式会社
経営企画室広報 IR 部
電話 (026) 283 - 6450 (直通)